

# 2023-2029年中国芯片设计 市场深度分析与市场年度调研报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2023-2029年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202302/338543.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》共九章。首先介绍了芯片设计行业市场发展环境、芯片设计整体运行态势等，接着分析了芯片设计行业市场运行的现状，然后介绍了芯片设计市场竞争格局。随后，报告对芯片设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片设计行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片设计产业有个系统的了解或者想投资芯片设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 芯片设计概况

#### 第一节 芯片设计沿革

##### 一、芯片设计定义

##### 二、发展历程

##### 三、技术沿革

##### 四、投资特性

##### 五、企业成长

#### 第二节 芯片设计当前发展综述

##### 一、芯片设计产销量分析

##### 二、当前技术、设备、生产工艺分析

##### 三、行业企业发展情况

##### 四、芯片设计所处经济周期

##### 五、行业景气性分析

##### 六、行业主要经济指标分析

#### 第三节 国内外代表性国家芯片设计发展对比

##### 一、发展模式

##### 二、技术特点

##### 三、芯片设计结构

## 四、企业发展

## 五、发展走向

### 第四节 国内外芯片设计发展存在的问题

### 第五节 国内外芯片设计发展的SWOT分析

## 第二章 芯片设计发展环境分析

### 第一节 芯片设计政策环境

#### 一、芯片设计规划

#### 二、税收政策

#### 三、投融资政策

#### 四、行业准入政策

### 第二节 芯片设计链环境

#### 一、上游行业发展分析

#### 二、下游市场发展分析

### 第三节 国际贸易环境

#### 一、国内进出口政策分析

#### 二、国外进出口政策分析

### 第四节 技术发展环境

#### 一、国内企业技术研发环境分析

#### 二、国内企业技术引进环境分析

#### 三、外资企业技术发展分析

#### 四、国内外技术标准分析

### 第五节 宏观经济环境

### 第六节 重点国家和地区芯片设计环境分析

## 第三章 芯片生产分析

### 第一节 行业芯片产量、产值分析

### 第二节 芯片生产成本与出厂价格分析

### 第三节 芯片当前产能配置分析

### 第四节 生产模式分析

### 第五节 芯片产销率与库存投资

### 第六节 芯片产出结构

## 第七节 芯片产出企业、地域集中度分析

## 第八节 不同地区生产情况分析

## 第九节 芯片生产技术发展

## 第十节 产量预测

## 第四章 芯片行业供给分析

### 第一节 芯片供给量分析

### 第二节 芯片供给方式分析

### 第三节 芯片供给错位情况分析

### 第四节 芯片供给过剩情况分析

### 第五节 芯片产量与实际供给量关系分析

### 第六节 主要芯片供给企业分析

### 第七节 主要芯片供给地区分析

### 第八节 近期芯片供给规律分析

### 第九节 不同芯片供给模式对比

### 第十节 芯片供给量预测

## 第五章 芯片行业需求分析

### 第一节 芯片需求量分析

### 第二节 芯片需求特点分析

### 第三节 芯片需求错位情况分析

### 第四节 芯片潜在需求开发分析

### 第五节 芯片消费量与实际需求量关系分析

### 第六节 主要芯片需求领域实际需求分析

### 第七节 主要芯片需求地区实际需求分析

### 第八节 近期芯片需求发展规律分析

### 第九节 不同芯片需求空间对比

### 第十节 芯片需求量预测

## 第六章 芯片设计细分市场分析

### 第一节 电子芯片市场

#### 一、电源管理芯片市场

- (一) 全球市场概况
- (二) 我国市场规模
- (三) 我国市场结构与特点
- (四) 市场发展预测
- (五) 主要竞争厂商

## 二、LED外延芯片市场

- (一) 主要竞争厂商
- (二) 芯片技术规划及发展趋势
- (三) 芯片性能与价格
- (四) 市场规模预测

## 第二节 通讯芯片市场

- 一、全球市场概况
- 二、主要竞争厂商

## 第三节 汽车芯片市场

- 一、全球市场概况
- 二、我国市场规模
- 三、主要竞争厂商

## 第四节 手机芯片市场

- 一、全球市场规模
- 二、我国市场规模
- 三、我国市场结构与特点
- 四、市场发展预测
- 五、主要竞争厂商

## 第五节 电视芯片市场

- 一、DLP(数码光处理)芯片
  - (一) 技术
  - (二) 掌握核心芯片技术的厂商
  - (三) 应用该技术的彩电厂商
- 二、LCOS芯片
  - (一) LCOS微显示器
  - (二) LCOS面板技术
  - (三) 主要优点

(四) 掌握核心芯片技术厂商

(五) 应用该技术的彩电厂商

### 三、数据机顶盒芯片

(一) 主要竞争厂商

(二) 国内机顶盒生产商及其芯片解决方案

(三) 芯片技术规划及发展趋势

(四) 芯片性能与价格

(五) 市场规模预测

## 第七章 行业重点企业分析

### 第一节 上海华虹(集团)有限公司

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

### 第二节 中星微电子

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

### 第三节 中芯国际

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

### 第四节 大唐微电子

一、经营与财务状况

二、竞争优势

三、发展前景

### 第五节 其他优势企业

一、杭州士兰微电子股份有限公司

二、有研硅谷

三、上海蓝光

四、扬州华夏

五、深圳方大

六、大连路美

七、中国台湾信越

八、中国台湾威盛电子

第六节 国外优势企业分析

一、意法半导体

二、飞利浦

三、德州仪器

四、英特尔

五、AMD

六、LG电子

七、国家半导体

八、FREESCALE

第八章 2023-2029年行业发展前景展望与预测

第一节 发展环境展望

一、宏观经济形势展望

二、政策走势及其影响

三、国际行业走势展望

第二节 相关行业发展展望

一、IC制造业展望

二、IC封装测试业展望

三、IC材料和设备行业展望

第三节 行业发展趋势展望

一、技术发展趋势展望

（一）芯片设计由ASIC向SOC转变

（二）设计方法由反向向正向转变

二、芯片发展趋势展望

三、行业竞争格局展望

第四节 芯片设计市场发展预测

一、2023-2029年中国芯片设计市场规模预测

二、细分市场规模预测

三、芯片结构预测



四、销售模式：由提供芯片向提供整体解决方案转变

## 第九章 芯片设计行业投资风险分析

第一节 宏观经济发展与芯片设计行业的相关性分析

第二节 政策风险评价

一、产业政策风险

二、信贷政策风险

三、金融政策风险

第三节 行业竞争风险

第四节 人力资源风险

第五节 行业风险综合评价

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202302/338543.html>